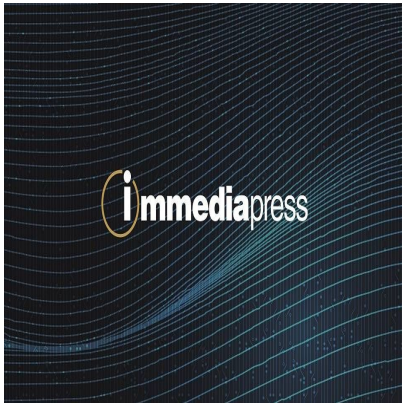




Supermicro amplia il portfolio integrato basato su Open Compute Project per accelerare le implementazioni di data center AI su scala rack

Descrizione

COMUNICATO STAMPA - CONTENUTO PROMOZIONALE

SAN JOSE, California, 14 ottobre 2026 /PRNewswire/ - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA, Enterprise, Storage e 5G/Edge con Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi un portfolio ampliato di sistemi, rack e scambiatori di calore per porte posteriori (RDHx) certificati Open Compute Project Accepted®. Grazie al supporto di DCBBS, il portfolio di soluzioni può essere integrato in implementazioni complete end-to-end a livello di rack e cluster.

L'esplosione dell'IA sta ridefinendo il modo in cui i data center vengono progettati, costruiti e implementati, e Supermicro è all'avanguardia di questa trasformazione con DCBBS, ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. Integrando elaborazione, rete, alimentazione, raffreddamento avanzato, software e servizi in soluzioni rack-scale validate, aiutiamo i clienti a semplificare la complessità e ad accelerare il percorso dall'innovazione alla produzione. DCBBS consente ai clienti di ridurre il TTM (Time To Market) e il TTO (Time To Factory) fornendo infrastrutture AI essenziali in modo più rapido ed efficiente.

Le soluzioni OCP di Supermicro sono ora disponibili, clicca qui per saperne di più.

Sfruttando le best practice della community OCP e la progettazione e i servizi DCBBS, gli operatori dei data center possono aumentare la densità di calcolo e l'efficienza energetica per i carichi di lavoro AI e HPC basandosi su una piattaforma aperta e validata a livello di rack, dai sistemi e busbar al raffreddamento a livello di rack e di data center, per portare online soluzioni ad alta densità in modo più efficiente e accelerare il Time-to-Market (TTM) e il TTO.

I clienti necessitano di un'infrastruttura aperta e flessibile, scalabile in base alle esigenze in rapida evoluzione dell'IA e al contempo adattabile alle caratteristiche dei loro data center, ha

dichiarato Dirk Van Slyke, vicepresidente del marketing di OCP. “Integrando sistemi, rack, alimentazione e raffreddamento certificati OCP in soluzioni rack-scale validate, Supermicro aiuta i clienti a semplificare l'integrazione, massimizzare la capacità e l'efficienza delle strutture e accelerare l'implementazione dell'infrastruttura IA di produzione.”

I rack ORv3 e ORW sostituiscono gli alimentatori e i cavi per server con una barra bus centralizzata a 48 V CC, consentendo ai clienti di ottimizzare i propri sistemi CPU e GPU per rack di calcolo ad alta densità. Questa densità è ulteriormente supportata dal sistema di raffreddamento a liquido Direct-to-Chip DLC-2 di Supermicro, che rimuove il calore in modo più efficiente da CPU, GPU e altri componenti critici, mentre il calore residuo può essere rimosso dal rack tramite gli appositi RDHx ORv3, senza la necessità di ulteriori modifiche ai sistemi di condizionamento dell'aria della sala server.

Le unità Supermicro RDHx possono essere montate sul retro dei rack ORv3 e ORW e rimuovono il calore residuo dai gas di scarico dei server prima che entrino nella sala dati. La gamma comprende soluzioni con capacità di raffreddamento da 10 kW a 120 kW, offrendo agli operatori una soluzione pratica per aumentare la densità dei rack sia nelle nuove strutture di intelligenza artificiale che nei data center esistenti. I modelli alimentati in corrente continua si collegano alla barra di distribuzione del rack per ridurre il cablaggio, mentre i design includono ventole ridondanti N+1 per garantire la continuità operativa e un sistema anticondensa intelligente per prevenire danni da umidità ad altri componenti all'interno del rack.

Gli operatori possono monitorare e gestire l'intera gamma di componenti DCBBS tramite SuperCloud Composer® utilizzando protocolli standard di settore. Inoltre, il software di Supermicro, come SuperCloud Director, SuperCloud Automation Assistant e SuperCloud Developer Console, consente alle organizzazioni di gestire e rendere operativi tutti gli aspetti delle moderne fabbriche di intelligenza artificiale, dei data center aziendali e dell'infrastruttura NeoCloud, attraverso una soluzione di controllo software unificata.

Come parte del portfolio DCBBS, Supermicro offre anche un portfolio completo di soluzioni di rete per l'intelligenza artificiale, che spaziano dagli switch Ethernet 800G e 1.6T raffreddati ad aria e a liquido, incluse le piattaforme Co-Packaged Optics (CPO) di nuova generazione basate sul silicio di switching Broadcom Tomahawk 6, ottimizzate per rack EIA o ORv3. Il sistema operativo di rete Supermicro Enterprise Advanced SONiC offre ai clienti la flessibilità di selezionare l'architettura di rete che meglio soddisfa i loro requisiti in termini di prestazioni, consumo energetico, scalabilità e implementazione, in un contesto di continua evoluzione per l'intelligenza artificiale e i data center su larga scala.

Supermicro DCBBS include anche i sistemi di switch Ethernet Photonics NVIDIA Spectrum-X, i primi switch Ethernet con SerDes a 200 Gb/s integrati. Basata sul chip ASIC Ethernet NVIDIA Spectrum-6 da 102,4 Tb/s, la tecnologia Spectrum-X Ethernet Photonics offre un'efficienza energetica 5 volte superiore, un MTBI (tempo medio tra gli errori) 10 volte maggiore, un uptime 5 volte più lungo per le applicazioni di intelligenza artificiale e tempi di implementazione 1,3 volte più rapidi rispetto alle reti basate su transceiver plug-in. La tecnologia Spectrum-X Ethernet Photonics è già in produzione.

Panoramica del portafoglio: L'ampio portfolio di soluzioni di Supermicro incorpora numerosi standard basati sulla community, che consentono di mettere online data center più veloci e ottimizzati in tempi più brevi.

Tra queste figurano:

Soluzione FlexTwin a 1 OU: Una soluzione HPC su rack appositamente progettata, composta da sistemi a 2 nodi da 1 OU basati sulle più recenti CPU Intel® Xeon® 6 o AMD EPYC.

NVIDIA Vera Rubin NVL72: La serie NVIDIA MGX 1.2 Rack di Supermicro, sviluppata in collaborazione con OCP, è progettata esclusivamente per le piattaforme CPU NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA Vera, con supporto per lo stack di raffreddamento a liquido DCBBS DLC-2 di Supermicro, per semplificare l'integrazione nel rack e accelerare l'implementazione.

2 OU NVIDIA HGX B300: Realizzato secondo le specifiche OCP ORv3 con tecnologia di raffreddamento a liquido avanzata, ogni nodo compatto a 8 GPU si adatta a rack da 21 pollici, consentendo fino a 18 nodi e un totale di 144 GPU per rack.

Soluzione rack-scale a 4 nodi e 2 unità organizzative: Architetture ottimizzate che sbloccano prestazioni, efficienza e densità di rack rivoluzionarie per l'IA agentiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con fino a 45.696 CPU Arm AGI per rack.

Unità CDU da 250 kW, formato 4U, installabile in rack: Offre un'elevata capacità di raffreddamento e un design compatto, con una potenza di raffreddamento fino a 250 kW in un formato compatto 4U. Supporta rack AI ad alta densità con raffreddamento ad acqua calda a 45°C e funzionamento efficiente dal punto di vista energetico nei data center.

Serie di rack OCP ORv3: Rack da 44OU e 48OU da 21 pollici con busbar integrate e una capacità di carico statico certificata di 2.268 kg (5.000 lb), architettura predisposta per il raffreddamento a liquido, design meccanico ottimizzato, inclusi i rack MGX 1.2 (Gen 3).

Soluzione piattaforma AMD Helios: Architettura ORW completamente integrata e progettata specificamente per l'inferenza ad alto volume, l'addestramento di modelli di frontiera, il fine-tuning e l'IA sovrana e agentica.

ORv3/Chiller Door: Compatibile con il rack ORv3, offre una capacità di raffreddamento da 20 a 100 kW e il controllo tramite Redfish/SNMP/WebUI/Modus.

Sportello per refrigeratore ORW: Compatibile con rack ORW, offre una capacità di raffreddamento di 60 kW e controllo tramite Redfish/SNMP/WebUI/Modus.

Fluidi refrigeranti DCBBS: Progettati per stack di raffreddamento a liquido in stile OCP, i clienti hanno a disposizione due liquidi refrigeranti PG pronti all'uso per il circuito TCS: DLC-1 per rack standard con raffreddamento a liquido e DLC-2 a bassissima conduttività per design speciali con piastre di raffreddamento. Entrambi sono progettati per essere compatibili con le specifiche di base OCP PG25, in modo che rack, unità CDU in rack, RDHx e piastre di raffreddamento possano funzionare come un unico gruppo di raffreddamento.

Scambiatore di calore per porta posteriore (RDHx): Sei soluzioni di raffreddamento montabili su rack che rimuovono il calore dai rack raffreddati a liquido. Le capacità di raffreddamento variano da 10 kW a 120 kW, con opzioni di alimentazione CA e CC disponibili.

Ripiani di alimentazione (1 OU) e UnitÃ di backup a batteria (2 OU) si adattano facilmente ai rack OCP.

Switch CPO a 2 unitÃ rack: Progettato per rack OCP ORv3 con alimentazione busbar da 40-60 V CC e raffreddamento a liquido QD08 a innesto cieco. Offre una velocitÃ di 102,4 Tbps su 128 porte 800G con supporto Supermicro Enterprise Advanced SONiC.

Software di gestione del sistema: Supporta le API Redfish e lâ??architettura basata su OpenBMC per la gestione remota. DisponibilitÃ di algoritmi di attestazione e PQC per la conformitÃ di sicurezza agli standard OCP.

DCBBS Ã lâ??approccio integrato di Supermicro per la creazione e lâ??implementazione di infrastrutture AI pronte per la produzione, dai sistemi rack alle fabbriche AI complete. DCBBS riunisce elaborazione accelerata, reti ad alte prestazioni, storage, alimentazione, raffreddamento a liquido avanzato, software di gestione del sistema e servizi di implementazione in soluzioni validate, ottimizzate e co-progettate per ciascun cliente. Unendo le capacitÃ ingegneristiche e produttive di Supermicro con ecosistemi tecnologici allâ??avanguardia, DCBBS aiuta le organizzazioni a ridurre la complessitÃ di implementazione e il costo totale di proprietÃ , ottimizzando al contempo prestazioni ed efficienza.

Scoprite queste e altre soluzioni presso lo stand Supermicro n. B4 allâ??OCP Global Summit, che si terrÃ dal 12 al 15 ottobre a San Jose, California.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) Ã leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operativa a San JosÃ©, in California, Supermicro si impegna a introdurre per prima sul mercato innovazioni destinate alle infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. Lâ??azienda offre soluzioni IT complete che comprendono server, sistemi per lâ??IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. Lâ??esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis ci consente di sviluppare e produrre soluzioni innovative di nuova generazione, dal cloud allâ??edge computing, per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere economie di scala ed efficienza, e sono ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietÃ (TCO) e ridurre lâ??impatto ambientale (Green Computing). Il pluripremiato portfolio di Server Building Block Solutions® permette ai clienti di ottimizzare le proprie soluzioni in base al carico di lavoro e allâ??applicazione specifica, scegliendo tra unâ??ampia gamma di sistemi basati sui nostri blocchi modulari flessibili e riutilizzabili, che supportano una gamma completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e â??We Keep IT Greenâ? sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e loghi sono di proprietÃ dei rispettivi proprietari.

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

COMUNICATO STAMPA â?? CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress Ã? un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dallâ??ente che lo emette. Lâ??Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

â??

immediapress/pr-newswire

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. ImmediaPress

Data di creazione

Ottobre 14, 2026

Autore

redazione

default watermark